

2021年1月25日
凸版印刷株式会社**凸版印刷、「TOKYO PACK 2021-東京国際包装展-」に出展**

持続可能な社会に貢献するためのパッケージのブランドとして

「TOPPAN S-VALUE™ Packaging」を新たに策定

「ひと」「しゃかい」「ちきゅう」の 카테고리別に製品を紹介

凸版印刷株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:磨 秀晴、以下 凸版印刷)は、2021年2月24日(水)から26日(金)に開催される「TOKYO PACK 2021-東京国際包装展-」(会場:東京ビッグサイト)に出展します。

私たちが直面する、気候変動や海洋プラスチックごみなどの環境問題、さらにポストコロナ時代に向けたデジタル化の急速な進展が、人々の生活や経済活動に大きな転換をもたらしています。そうした中で凸版印刷はパッケージ分野において、持続可能な社会に貢献するための新ブランドとして、「TOPPAN S-VALUE™ Packaging」を新たに策定。『「価値あるパッケージ」で、よりよい社会と心豊かで快適な生活に貢献する』というビジョンの基に事業展開を図ってまいります。

今回、凸版印刷ブース(南1ホール・小間番号S1-12)では、「TOPPAN S-VALUE™ Packaging」における「ひと」「しゃかい」「ちきゅう」の3つのカテゴリーごとに、抗ウイルスパッケージやDXソリューション、モノマテリアルバリアパッケージを含む環境配慮型パッケージなど、凸版印刷の開発製品や技術・ソリューションを紹介いたします。

また、今回TOKYO PACK 2021の開催期間中に合わせて、凸版印刷のオンライン展示会プラットフォーム「V-MESSE™」を活用したバーチャル展示会を独自開催します。

URL: <https://v-messe.jp/custom/plaza/2021/tokyopack/>

バーチャル展示会では、リアルの展示内容と同一のコンテンツやセミナーをオンラインで公開します。



「TOKYO PACK 2021」凸版印刷ブースイメージ © Toppan Printing Co., Ltd.

■ 「TOPPAN S-VALUE™ Packaging」について



凸版印刷は、「価値あるパッケージ」で、よりよい社会と心豊かで快適な生活に貢献する「TOPPAN S-VALUE™ Packaging」を掲げ、「ひと」に価値ある「スマートライフバリュー パッケージ」、「しゅかい」に価値ある「ソーシャルバリュー パッケージ」、「ちきゅう」に価値ある「サステナブルバリューパッケージ」を提供します。

「ひと」/「スマートライフ バリュー パッケージ™」



円滑な購入や効率的な保管、美味しく仕上がる調理、簡便な廃棄、安全・安心な取扱いなど、生活のさまざまな場面に最適な価値を提供し、コミュニケーション媒体として顧客体験を最大化させるソリューションを展開します。

「しゅかい」/「ソーシャル バリュー パッケージ™」



サプライチェーンにおいて発生する業務効率化、生産性向上、販売の最適化などのさまざまな課題を解決し、継続的な企業活動を実現する価値あるパッケージやサービスを展開します。

「ちきゅう」/「サステナブル バリュー パッケージ™」



再生プラスチックを用いた包装材、単一素材でリサイクル適性を向上した包装材、植物由来材料の紙やバイオマスプラスチックを用いた包装材など、環境負荷の低減と循環型社会の実現につながるソリューションを展開します。

<URL>

<https://www.toppan.co.jp/living-industry/packaging/sustainability/>

■ 主な展示内容

新たに策定した「TOPPAN S-VALUE™ Packaging」のそれぞれ3つのカテゴリーに分けたコンセプト展示を行います。

「ひと」/「スマートライフ バリュー パッケージ™」ブース

生活スタイルの変化や消費者意識に対応した安全・安心な抗ウイルスパッケージや、暮らしの利便性を向上させる電子レンジ包材など、快適な生活に貢献する製品を展示します。

「しゅかい」/「ソーシャル バリュー パッケージ™」ブース

トッパンの製造DXソリューション「NAVINECT®」「SDNECT™」を中心に、ニューノーマル時代に求められる事業変革を実現する製品を展示します。

「ちきゅう」/「サステナブル バリュー パッケージ™」ブース

資源循環を見据えたモノマテリアルバリアパッケージや、再生材を利用したパッケージ、紙化製品など、直近のニーズを反映した環境に配慮した製品を展示します。

■「TOKYO PACK 2021」について

名称:TOKYO PACK 2021 ー東京国際包装展ー

会期:2021年2月24日(水)～26日(金)

開場時間:10:00～17:00(来場登録受付開始 9:30)

会場:東京ビッグサイト 西1～4ホール、南1～2ホール

テーマ:未来(あす)を拓く 包みのテクノロジー

主催:公益社団法人日本包装技術協会

公式サイト URL: <https://www.tokyo-pack.jp/>

凸版印刷のオンライン展示会サイト URL: <https://v-messe.jp/custom/plaza/2021/tokyopack/>

■アクセス情報

・東京ビッグサイトまでのアクセス

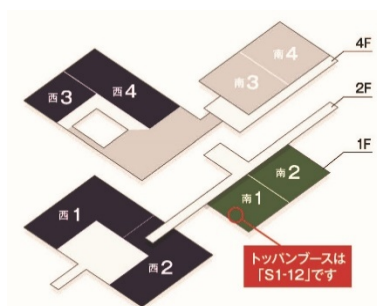
りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩7分)

ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅下車(下車 徒歩3分)

・トッパンブースへのアクセス

TOPPAN ブース位置

南1ホール 小間番号 S1-12



* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以上